

RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2017

()

“Por la cual se adopta la Guía de diseño de pavimentos con placa huella”

EL MINISTRO DE TRANSPORTE

En ejercicio de las facultades legales, especialmente las que le confiere el artículo 13 parágrafo 3 de la Ley 105 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2618 de 2013, corresponde al Instituto Nacional de Vías, entre otras funciones, elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia, así como, definir la regulación técnica relacionada con la infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.

Que existe la necesidad de adelantar y continuar programas de pavimentación de vías de bajo tránsito, que sirven de acceso a las vías principales para comunicar a las comunidades localizadas en zona de influencia, con las carreteras de segundo y primer orden y acceder de esta manera a los centros de consumo.

Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el contrato No. 1239 de 2015, con el Consorcio Manuales y Guías Ceal para la elaboración de la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella.

Que la Guía de diseño de pavimentos con placa huella elaborada por el Consorcio Manuales y Guías Ceal, fue socializado el día 13 de abril de 2016, con los Gremios de la Ingeniería, la Academia, las firmas consultoras, así como con las Entidades Estatales.

Que se hace necesario, adoptar la Guía de diseño de pavimentos con placa huella, para la construcción de vías terciarias como alternativa de pavimentación en los contratos que adelanta el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS – deberá conservar los documentos asociados al proceso de divulgación y participación ciudadana, incluidos los cronogramas, actas, comentarios, grabaciones e informes que evidencien la publicidad del proyecto y la participación de los ciudadanos y grupos de interés, todo ello en concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

“Por la cual se adopta la Guía de diseño de pavimentos con placa huella

Que mediante memorando 20175000015793 de 2017, el Director de Infraestructura del Ministerio de Transporte, solicita la emisión del acto administrativo respectivo.

Que el contenido de la presente resolución, fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte, en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, a partir del 23 de febrero de 2017, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1: Adoptar la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella, para el diseño y construcción de vías terciarias a cargo del Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, la cual hace parte de la presente resolución y consta de 93 hojas.

Artículo 2. El Instituto Nacional de Vías –INVIAS deberá tener en sus archivos todos los documentos (antecedentes) que sirvieron de sustento para la expedición de presente acto administrativo y tenerlos a disposición de las autoridades que los requieran.

Artículo 3: La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
Ministro de Transporte

Carlos Alberto García Montes, Director General “INVIAS”
Luis Roberto D’Pablo Ramírez, Director Técnico “INVIAS”
María Eugenia Vera Castro, Jefe Oficina Asesora Jurídica “INVIAS”
Carlos Alberto Valencia Escobar, Subdirector de Estudios e Innovación “INVIAS”
Alfonso Montejo Fonseca “INVIAS”
Dimitri Zaninovich – Viceministro de Infraestructura
Jorge Rivillas – Asesor Despacho Ministro
Javier Monsalve- Director de Infraestructura – Ministerio de Transporte
Amparo Lotero z – Jefe Oficina Asesora Jurídica – Ministerio de Transporte
Claudia Montoya C – Grupo Conceptos y Apoyo Legal Ministerio de Transporte.